

2015年12月期第2四半期 決算説明資料

株式会社RS Technologies
東証マザーズ：3445

注意事項

- 当該資料に記載された内容は、一般的に認識されている経済情勢及び当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営を取りまく様々な環境の変化により、予告なしに変更される可能性があります。
- 本発表において提供される資料ならびに情報の中には「見通し情報」が含まれております。これらの情報は、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実際には異なる結果となる不確実性を含んでおります。
- 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。
- 2014年12月期第2四半期の財務数値につきましては、有限責任 あずさ監査法人の四半期レビューおよび監査を受けたものではありません。

目次

2015年12月期第2四半期決算情報	P. 4- 7
中・長期的な経営方針	P. 8-13
2015年12月期第3四半期以降の取り組み	P.14-16
参考資料	P.17-24

2015年12月期第2四半期 決算情報

2015年12月期第2四半期決算情報 ☆ サマリー ☆

■ 第2四半期も第1四半期に引き続き、業績は好調を維持 ■

単位：百万円

	2015年12月期 第2四半期 (2015年1~6月)	2014年12月期 第2四半期 (2014年1~6月)	前四半 期累計 同期比	2015年12月期 予想 (2015年1~12月)	進捗率
売上高	2,475	2,245	110.2%	5,486	45.1%
営業利益	608	516	117.8%	927	65.6%
営業利益率	24.6%	23.0%	+1.6pt	16.9%	-
経常利益	582	398	146.2%	849	68.6%
経常利益率	23.5%	17.7%	+5.8pt	15.5%	-
当期(四半期) 純利益	235	240	97.9%	420	56.0%

※2015年12月期予想数値は、平成27年3月24日付の「東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ」で公表しました数値と変更はございません。

2015年12月期第2四半期決算情報 — 連結損益計算書 —

【当四半期業績のポイント】

単位：百万円

	2015年12月期		2014年12月期		比較増減
	第2四半期 (2015年1~6月)	第2四半期 (2014年1~6月)	第2四半期 (2014年1~6月)	比較増減	
売上高	2,475	2,245		230	
売上原価	1,528	1,430		98	
販売費・一般管理費	337	298		39	
営業利益	608	516		92	
(%)	24.6%	23.0%		1.6%	
営業外損益	△ 26	△ 118		92	
経常利益	582	398		184	
(%)	23.5%	17.7%		5.8%	
特別損益	△ 217	-		△ 217	
税引前当期利益	364	398		△ 34	
法人税等	129	157		△ 28	
当期利益	235	240		△ 5	
(%)	9.5%	10.7%		-1.2%	

■ 売上高

・売上高は、前年同期比で10.2%増加。

■ 売上原価

・売上原価率は前年と同水準で推移。

営業利益は608百万円 営業利益率24.6%

前第2四半期には設備投資に伴う調達資金に係るコスト 125百万円が営業外費用で発生（当第2四半期はなし）

設備移設費用（三本木工場内）は特別損益で発生。

当期利益は235百万円 当期利益率9.5%

2015年12月期第2四半期決算情報 — 連結貸借対照表 —

単位：百万円

	2015年度 第2四半期末	2014年度 年度末	比較増減
資産の部			
現金及び預金	2,243	1,190	1,053
売上債権	881	697	184
たな卸資産	538	524	14
未収入金	2,443	11	2,432
その他流動資産	303	338	△ 35
有形固定資産	4,830	3,918	912
無形固定資産	13	15	△ 2
その他固定資産	81	130	△ 49
資産合計	11,332	6,824	4,508
負債の部			
支払手形及び買掛金	171	151	20
短期借入金	267	483	△ 216
1年内返済長期借入金	3,496	344	3,152
長期借入金	4,074	2,926	1,148
その他流動負債	497	1,315	△ 818
その他固定負債	194	9	185
計	8,699	5,228	3,471
純資産の部			
資本金	616	199	417
資本剰余金	616	199	417
利益剰余金	1,343	1,114	229
その他	57	84	△ 27
計	2,633	1,596	1,037
負債・純資産合計	11,332	6,824	4,508

【主要科目のポイント】

■未収入金

先端設備投資に係る補助金収入 2,443百万円
当第3四半期入金見込
(追加) 2015/8/14に、受領しました。

■有形固定資産

増加。三本木工場に最新の設備を導入。本年6月より稼働。

■有利子負債

(短期借入金、1年内返済長期借入金、長期借入金)

増加。先端設備投資に係る借入実行済み。当第3四半期補助金(入金額2,443百万円)入金後に、2,732百万円返済予定。
(追加) 2015/8/14補助金を受領しましたので、銀行約定により9月末返済する予定です。

中・長期的な経営方針

中・長期的な経営方針

●今期のトピックス●
 ①事業計画通りの新設・増設による生産力拡大

②再生市場での当社のシェア拡大

③伸長する需要の取込み

④潜在的な再生市場の開拓

⑤中国半導体マーケットへの参入

2015/3/24 当社発表「成長可能性に関する説明資料」より一部抜粋

「事業計画通りの新設・増設による生産力拡大」

～●今期のトピックス●当社300mmウェー八月産生産能力推移～

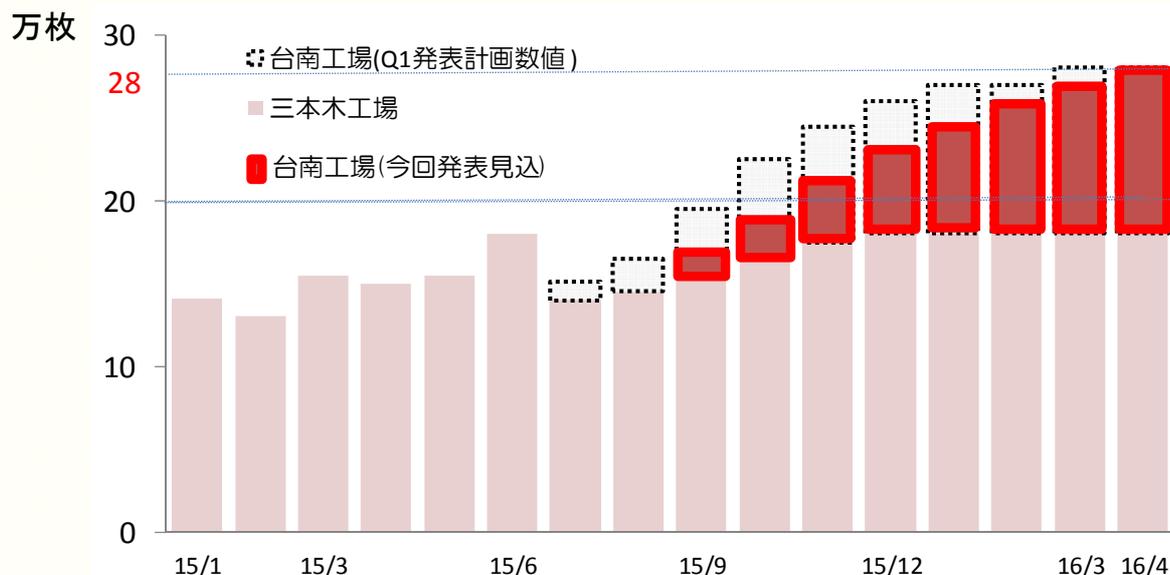
	2015/6末時点	2015/9末予想	2015/12末予想
三本木工場 (宮城県大崎市)	16 → 18 万枚 (2015/6から 売上寄与)	16 → 18 万枚	16 → 18 万枚
台南工場 (台湾台南市)	- 万枚	10 万枚 (2015/9から 生産開始予定)	10 万枚
合計	18 万枚	28 万枚	28 万枚

青字・・・前回発表数値
 赤字・・・今回変更数値

合理化・スループット向上により、三本木工場の生産能力が上がりました。

「事業計画通りの新設・増設による生産力拡大」

～●今期のトピックス●三本木工場と台南工場300mmウェーハ出荷枚数推移～



2015/1～2015/7は実績の出荷枚数 2015/8以降は見込の出荷枚数

Q1発表時は、補助金審査のスケジュールが未確定でした。

今回は補助金審査が終わり、台湾への設備も移設完了したことから、台湾稼働は9月予定です。

2016/4に、三本木工場18万枚、台南工場10万枚を目標とします。

2015年度中期計画の概要

単位：百万円

会計年度	2014/12 (実績)	2015/12 (計画)	2016/12 (計画)	2017/12 (計画)
売上高	4,566	5,486	7,276	7,442
営業利益	1,166	927	1,820	1,912
当期純利益	664	420	1,263	1,324

【前提】（2015年度～2017年度）

為替
109.5 円/USドル

2015/3/24 当社発表「成長可能性に関する説明資料」より抜粋

2015年度中期計画の概要②

会計年度	2014/12 (実績)	2015/12 (計画)	2016/12 (計画)	2017/12 (計画)
R O E	45.0 %	14.5 %	30.3 %	24.1 %
自己資本比率	21.6 %	33.2 %	44.7 %	56.0 %

～直近本決算期 同業他社情報～ 注) 当社の直近本決算数値は上場前のため、2015/12月期予算数値を使用

	信越化学工業様 (2015/3月期 決算 短信より引用)	三益半導体工業様 (2015/5月期 決算 短信より引用)	SUMCO様 (2014/12月期 決算 短信より)	当社 (2015/12月期年度予 算より)	上場企業平均値 (当社調べ)
ROE	6.9 %	3.2 %	9.2 %	14.5 %	8.0 %
自己資本比率	79.9 %	71.7 %	36.2 %	33.2 %	50.0 %

※ROE=自己資本当期純利益率 (当期純利益÷自己資本)

※自己資本比率 (自己資本÷総資産)

2015年12月期 第3四半期以降の取り組み



2014年～2015年にかけて実施していたSR7⇒SR8への300mmウェーハ製造拠点の移設が完了しました。
最新鋭の設備を使用し、300mmウェーハの量産を開始しております。
また、450mmウェーハの製造装置は、現在立ち上げ中で世界に先駆けて量産体制を構築中です。

台南工場への新設

■台湾への進出

台湾は半導体の集積地で、世界で現在最も重要視されている市場となります。
なかでも、台南には今後も、半導体工場の新設が予定されており、それに併せて
当社も台南に進出しました。

既に、日本国内から製造設備を搬入済みで、立上作業中です。

会社名	艾爾斯半導體股份有限公司
資本金	NT\$2億（7.4億円）
設立	2014年2月
操業開始	2015年9月予定
生産能力 （新設）	月産10万枚／300mmウェーハ
事業内容	半導体用シリコンウェーハの再生加工、販売



ご参考

会社概要

社名	株式会社 RS Technologies
本社	東京都品川区大井1-23-1 カクタビル 4F
三本木工場	宮城県大崎市三本木音無字山崎26-2
台南工場	No.1 Nanke 7th Rd., Southern Taiwan Science Park, Tainan City 74144 Taiwan
経営理念	「地球環境を大切にし、世界の人々に信頼され、 常に創造し挑戦する。」
資本金	61,645万円（2015年3月31日時点）
取締役	方永義、鈴木正行、本郷邦夫、近藤淳行 石黒正亨、李宗根、渡邊泰紀、内海忠
設立	2010年12月10日
操業開始	2011年1月1日
事業内容	半導体用シリコンウェーハの再生、加工、販売、 ソーラー売電 半導体製造設備・半導体部材販売

シリコンウェーハ再生事業-半導体とウェーハ

各種電気製品や自動車等の基幹部品となる半導体は円盤状のシリコンウェーハから作られます。
我々は**使用済みシリコンウェーハの再利用を目的として、精密加工を行う会社**です。

シリコンウェーハ再生事業-半導体の用途



スマホ・タブレット
 ・ウェアラブル・自動運転
 ・家・ビル・町・**M2M**・・・etc



世界の半導体の需要は

- ★ 世界の人口増
- ★ 新興国の経済発展
- ★ 先進国のデバイス用途の多様化

により拡大



シリコンウェーハ再生事業-半導体製造概要

半導体製造のおおまかな流れ



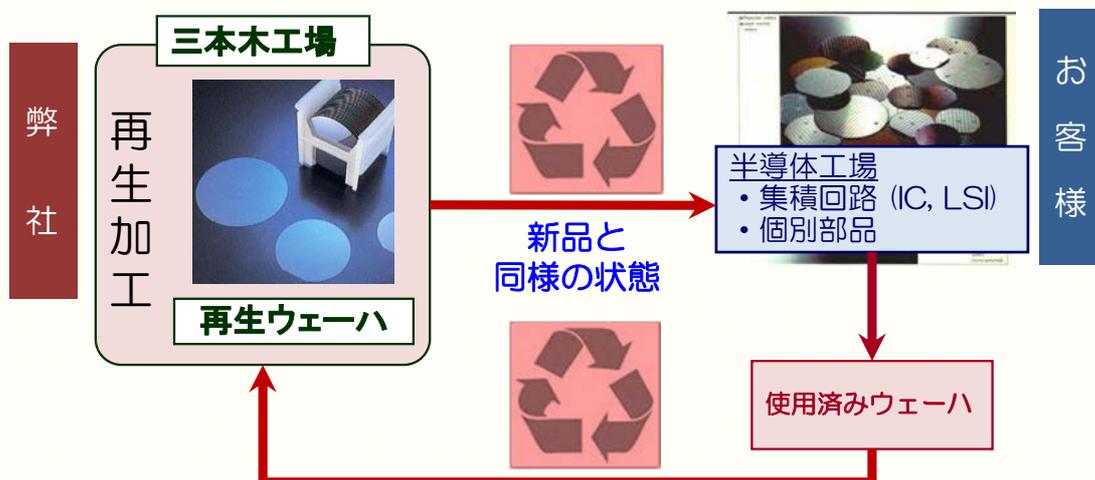
当社の再生ウェーハが大量に使用されます。

シリコンウェーハ再生事業-再生とは？

半導体工場では700を超える工程がありますが、各工程のプロセス評価、出来栄への評価のために『モニタウェーハ』が使用されます。これらのモニタウェーハは、1回～数回使用されると使用不可となりますが、弊社は、これらのウェーハをお預かりし、精密加工をすることで再利用が可能な新品と同様の状態に戻し、同じ用途で使用していただくサービスを提供しております。

再生ウェーハはシリコンウェーハ全使用量に対し、約21%の需要があります。

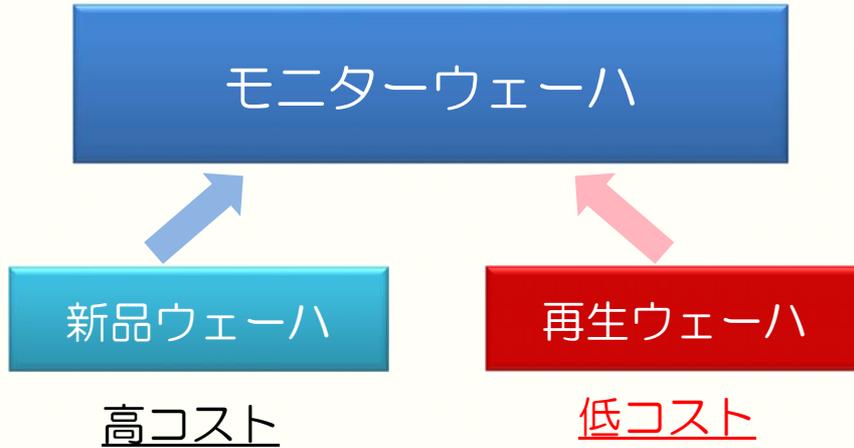
(SEMI 2012実績)



シリコンウェーハ再生事業-なぜ再生が必要か？

◇◇ なぜ再生ウェーハの需要があるのか？ ◇◇

◎一番の目的は、お客様の**コストダウン**のためです。



※環境負荷を減らすという目的もあります。

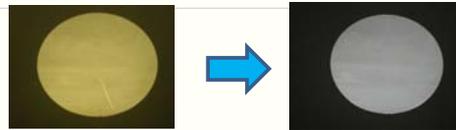
シリコンウェーハ再生事業

工程概要と 当社の強み



・強み①(すべての膜を剥離可能)
ケミカルによる除去の為、表面のダメージが最小限に→「再生回数が多い」→よりコストダウンが可能に。

★ラサ工業(化学)の特異技術を承継



・表面に付いているキズや凹凸を研磨(ポリッシング)により平滑にする



・強み②(金属不純物を除去)
ウェーハ表面の微細ゴミ、汚れ、を洗浄で取り除く
+ 金属不純物の除去
特に銅 (Cu) の汚染除去に強み

